

200MByte/s 芯片烧写全球最快

SmartPRO 6000 编程器



极致的编程速度



成熟的烧录方案



高效压杆机构



免费试用

极致的编程速度

芯片能写多快，我们就能编多快

采用全新 Smart-FPS 架构的 SmartPRO 6000 编程器，内含专为编程应用优化的 4 核高性能处理器，配合 BlueThunder(蓝电)引擎，实现 200MByte/s 的理论数据传输带宽，远超目前芯片极限，并可支持高达 2TB 的高密度器件编程。

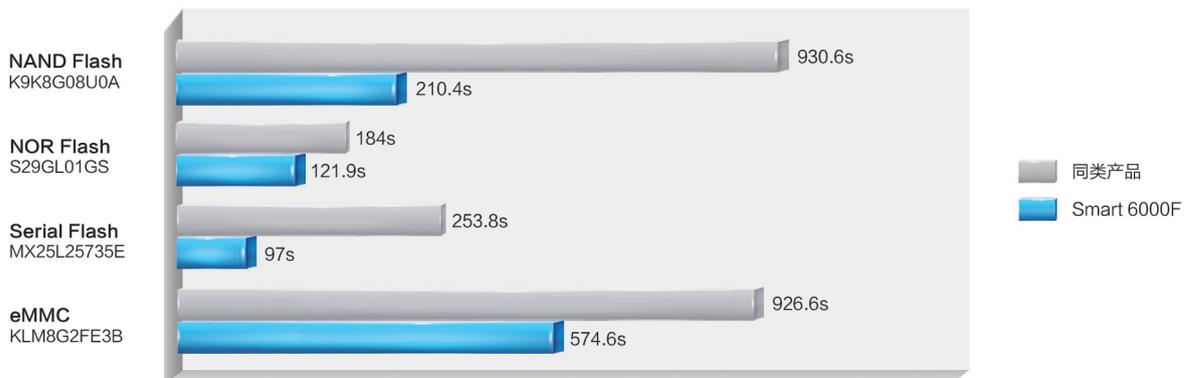


SmartPRO 6000 编程器相对于同类产品，在 eMMC、Nand Flash、Serial Flash 等芯片烧录速度上都有卓越提升。

包含主要应用的全功能安卓系统

烧写一片仅需 6 秒

以SAMSUNG KLMAG2GE4A-A001芯片为例



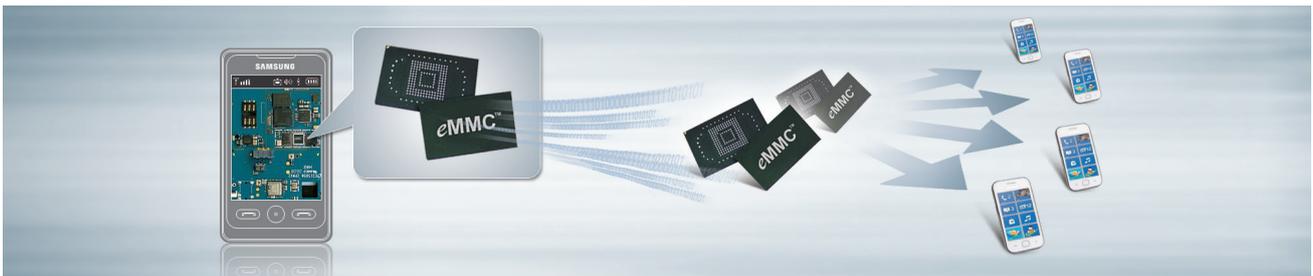
SmartPRO 6000与同类编程器速度对比图

独有的NAND FLASH/eMMC母片分析功能

自己设置烧录工程	使用母片分析
	
<p>王小姐从事芯片烧录管理工作，以前烧录NAND FLASH时需要请研发工程师到现场，工程设置复杂、测试频繁，导致进展缓慢。</p>	<p>现在使用母片分析功能，只点击几下鼠标，软件自动生成所需工程，复杂烧写算法轻松搞定。</p>

eMMC烧录方案

支持多种烧录模式		
操作模式	操作	特点
普通存储模式	将User Area当做普通存储器使用	无需分区，只把EMMC当做普通存储器使用
自定义分区模式	自定义Partition分割，根据用户自己的应用设置分区	高级应用，制作母片
母片扫描模式	智能分析母片的所有分区及数据，并将母片的分区、数据完整地拷贝到子片上去	批量拷贝母片



★已在三星、HTC、小米、魅族……等手机上成功应用★

NAND FLASH烧录方案

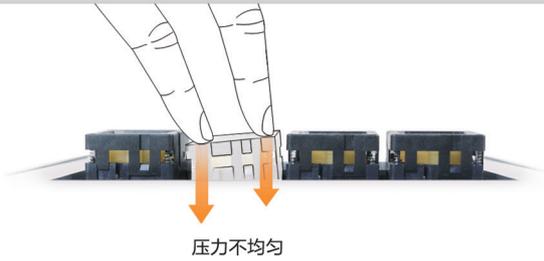
支持多种烧录方式		
烧录方式	操作	特点
文件镜像	用户将文件镜像调入至指定地址中	可灵活配置，方便程序升级
母片分析	用户提供一颗可以正常运行的母片	智能分析母片数据、分区，操作简单
用户定制	用户提出定制需求	量身定做



高效压杆机构

提升编程效率、延长适配器寿命、有效降低配件成本

传统的手指直接按压



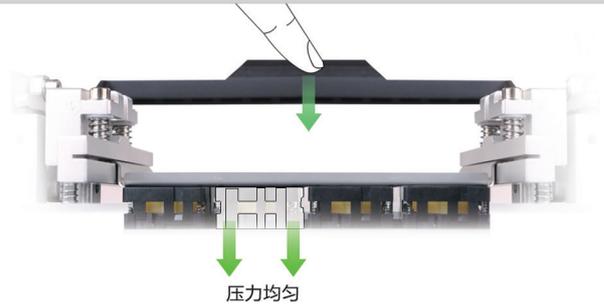
压力不均匀

压力不平均，导致适配器加速磨损



以1Kg压力的适配器为例，假设每天烧写1000片芯片，您两根手指压下的力度总和为： $F = 1\text{Kg} * 1000\text{pcs} * 2 = 2\text{T}$

使用压杆按压



压力均匀

延长适配器使用寿命，降低综合成本

压力平均且垂直，减缓适配器磨损，延长使用寿命1.3倍到1.5倍



轻松烧写，减轻操作疲劳度

压杆的压力变比系数 $K = 10$ ，在同样条件下，您每天按下的压力总和仅为： $F = 1\text{Kg} * 1000\text{pcs} / 4 / 10 = 25\text{Kg}$

扫描下图二维码或登陆

www.zlg.cn

申请试用。



致远电子分销商